



發佈日期：

2011 年 1 月 10 日

發佈單位：

達能科技股份有限公司

達能科技於2011年1月11日舉辦晶圓二廠第二期工程動土典禮

達能科技股份有限公司 (股票代號：3686) 於 2011 年 1 月 11 日於桃園縣觀音鄉桃園科技工業園區舉行晶圓二廠第二期工程動土典禮。為因應客戶對晶片產能的需求，達能科技馬不停蹄加速擴產腳步，提前進行晶圓二廠第二期的工程，規劃所需之資本支出預算總金額為新台幣 27 億元，建置約 200MW 廠房與產能設備，預計今年第三季完工並開始投產，屆時一、二廠總產能將上看 520MW。

達能科技 2010 年 12 月營業收入達新台幣 4.62 億元，較去年同期之 1.54 億元，增加新台幣 3.08 億元，大幅成長 200%，連續第十八個月創新高。2010 年 1 至 12 月累計營業收入為新台幣 36.07 億元，較去年同期之 12.77 億元，增加 23.30 億元，成長 182%。在二廠產能持續開出加持下，今年營收可望繼續向上攀升。

關於達能科技：

達能科技為國內第一家以科技類股上市的太陽能矽晶圓廠，擁有完整的矽晶圓生產線，以頂尖研發實力傲視業界，其多晶矽晶圓優異的品質及轉換效能表現，已普遍獲得國際太陽能電池大廠認證採用；除了多晶矽晶圓核心技術的品質見證，達能更加強矽晶材料技術的研發，以最先進的生產及品質提升設備，保持品質與成本領先的優勢地位。

聯絡人：

吳育宜

財務長

pr@danentech.com

+886 3 4738788